5270

D-SUB Steckverbinder - SMT - 90° Notebook Version

D-SUB Connector - SMT - Right-Angled Notebook Type

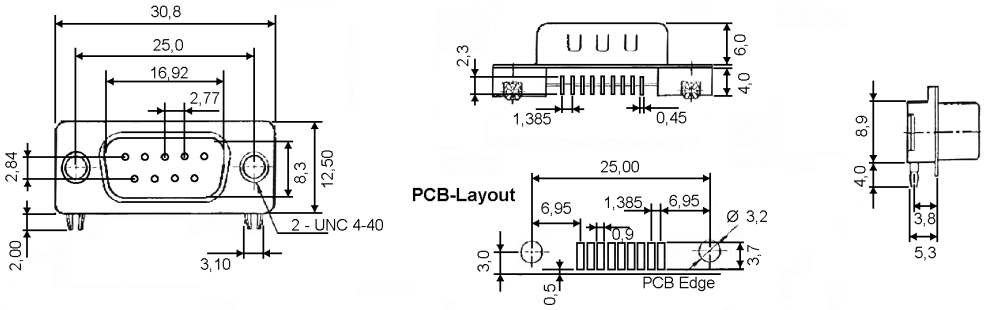
Technische Daten / *Technical Data*:

Gehäuse	Stahl vernickelt, verzinnt
Shell	*steel, tin coated over nickel*
Isolierkörper	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94V0
Insulator	*Thermoplastic, rated UL94V0*
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Contact Material	*copper alloy*
Kontaktoberfläche	Gold über Nickel
Contact Surface	*gold plated over nickel*
Lötbarkeit	IEC512-12A
Solderability	*IEC512-12A*
Durchgangswiderstand	≤ 10 mOhm
Contact Resistance	*≤ 10 mOhm*
Isolationswiderstand	> 10^9 Ohm
Insulation Resistance	*> 10^9 Ohm*
Spannungsfestigkeit	1000 V_{AC}
Test Voltage	*1000 V_{AC}*
Nennstrom	5 A
Current Rating	*5 A*
Temperaturbereich	-55°C...+125°C
Temperature Range	*-55°C...+125°C*
Verarbeitung	Reflow-Lötverfahren; weitere Informationen in Kapitel T
Processing	*Reflow-Soldering, further informations in chapter T*

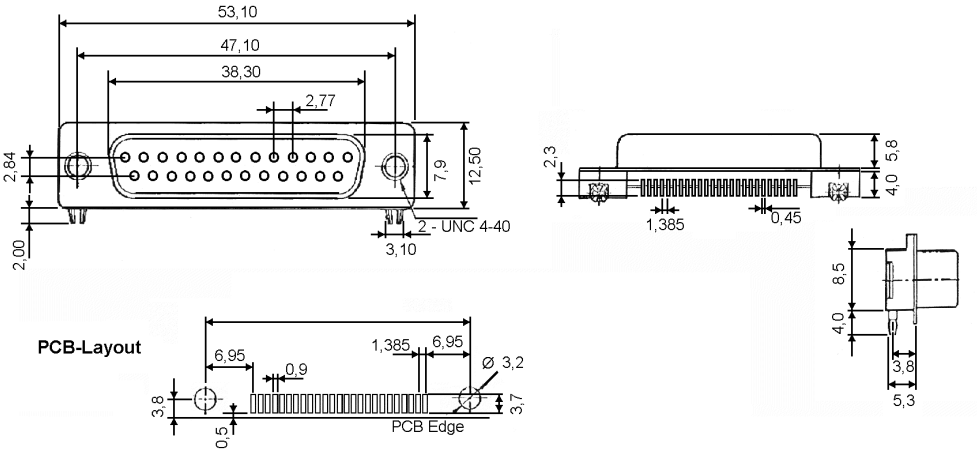
© W+P PRODUCTS

C

9-poles - male



25-poles - female



Series	*Contacts**	*Terminal**	*Quality**
5270	09	1	3
	09-pol.: für Stift verfügbar *available for male type* **25**-pol.: für Buchse verfügbar *available for female type*	**1** = Stift *male* **2** = Buchse *female*	**GK 1** = min. 500 Zyklen *quality class 1* **GK 2** = min. 200 Zyklen *quality class 2* **GK 3** = min. 50 Zyklen *quality class 3*

(* Bestellbeispiel - Bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
** Order example - To be replaced by your specifications.*)

TEL.: +49 5223 98507-0
FAX : +49 5223 98507-50

W+P PRODUCTS

E-MAIL: sales@wppro.com
INTERNET: www.wppro.com

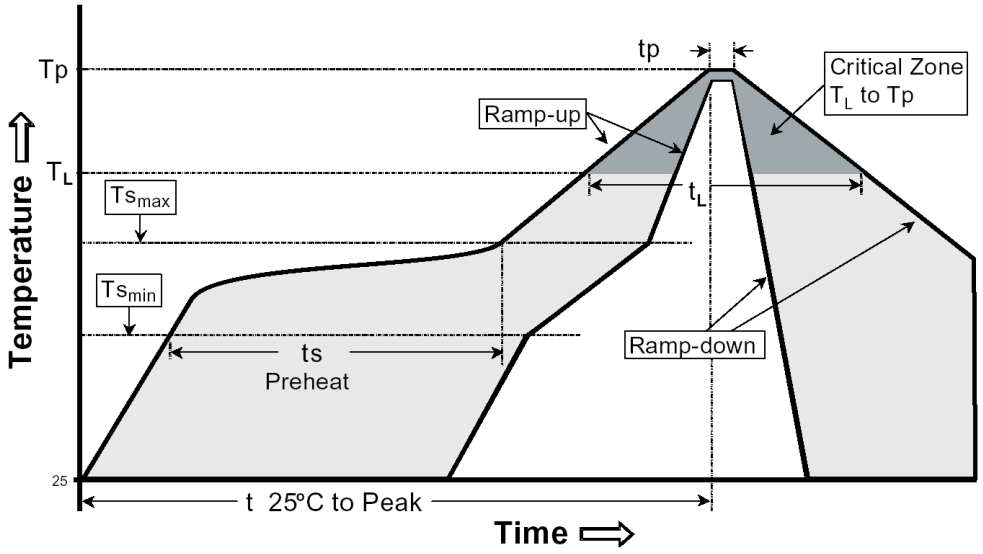
Reflow-Lötverfahren
Reflow-Soldering

Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflowverfahren verarbeitet werden (Maximalwerte):

Profil Eigenschaft	**Bleifreies Löten**
Durchschnitts-Ramp-Up Rate (Ts_{max} to Tp)	3 °C / Sek. Max.
Vorheizen - Temperatur Min (Ts_{min}) - Temperatur Max (Ts_{max}) - Zeit (ts_{min} auf ts_{max})	 150°C 200°C 60-180 Sekunden
Verbleiben oberhalb: - Temperatur (T_L) - Zeit (t_L)	 217°C 60-150 Sekunden
Peak/Klassifizierung Temperatur (Tp)	260°C +/- 5°C
Zeit innerhalb von 5°C um die Peak-Temperatur (tp)	20-40 Sekunden
Ramp-Down Rate	6°C / Sekunde max.
Zeit von 25°C bis zur Peak-Temperatur	8 Minuten max.

© W+P PRODUCTS

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature-profile for leadfree reflow-soldering (maximum values):

Profile Feature	**PB-Free assembly**
Average Ramp-Up Rate (Ts_{max} to Tp)	3 °C / second max.
Preheat - Temperature Min (Ts_{min}) - Temperature Max (Ts_{max}) - Time (ts_{min} to ts_{max})	 150°C 200°C 60-180 seconds
Time maintained above: - Temperature (T_L) - Time (t_L)	 217°C 60-150 seconds
Peak/Classification Temperature (Tp)	260°C +/- 5°C
Time within 5°C of actual Peak Temperature (tp)	20-40 seconds
Ramp-Down Rate	6°C / second max.
Time 25°C to Peak Temperature	8 minutes max.

Empfohlenes Reflow-Lötprofil:
Recommended Reflow-Soldering profile: